

## Produktbeschreibung:

100% nagelneu und hohe Qualität!!

Kolophonium Flussmittel wird verwendet, um das Löten zu erleichtern.

Es reinigt und verhindert die Oxidation von Metallen, wodurch das Lötmedium starke, lang anhaltende mechanische und elektrische Bindungen erzeugt.

Es dient auch als Netzmittel, wodurch der Lotfluss und die Effizienz des Lötprozesses erhöht werden.

Perfekt für Mobiltelefone, PC-Karten und andere anspruchsvolle elektronische Chip-Level-Flussschweißen.

## Spezifikationen:

Produkt: BST-21503A

Schmelzpunkt: 60 °C

Gewicht: 150g / pc

## PRODUCT DISPLAY

---



## PRODUCT DETAILS



Name: Soldering Paste

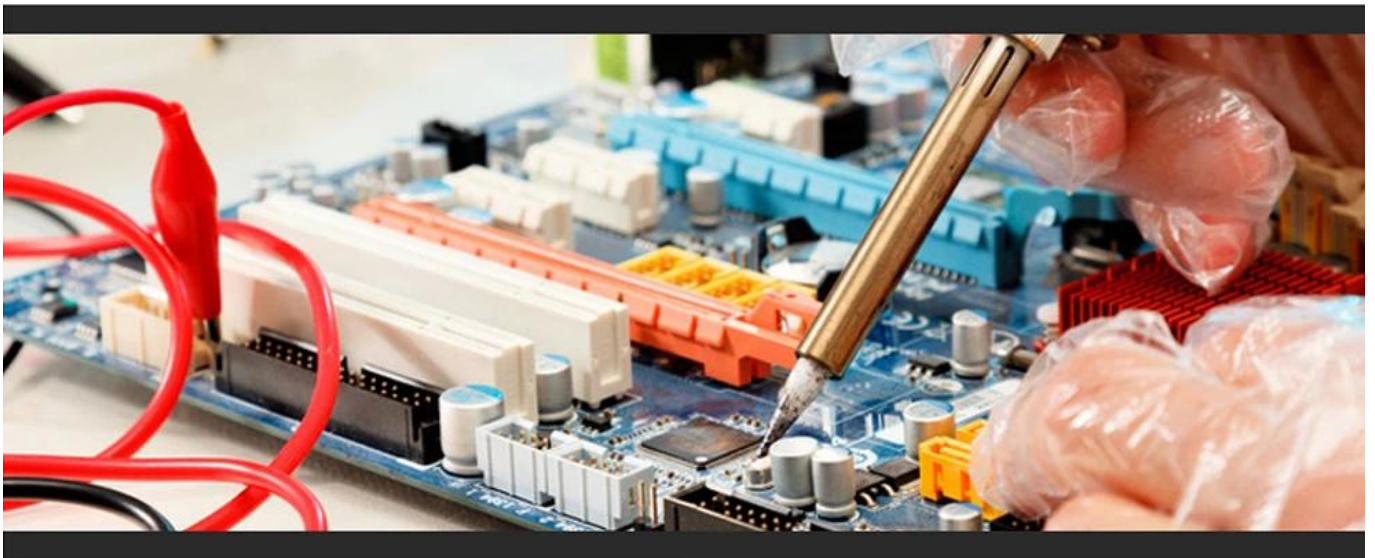
Size:  $\Phi 80 \times 45\text{mm}$

Composition: Solder powder, resin

Model: BST-21503A

Weight: 100g

Melting point:  $60^{\circ}\text{C}$





- ▲ Stable performance, Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- ▲ Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- ▲ The IC and PCB are not corrosive
- ▲ Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

**Features:** Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.



PRODUCT PHOTOGRAPH



